

深圳市英唐智能控制股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者
时间	2025年05月13日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 胡庆周 董事、财务总监 杨松 董事会秘书、副总经理 李昊 独立董事 陈俊发 极光微事业部负责人 黄春强 英华微事业部负责人 杨楠 持续督导保荐代表人 邱羽
投资者关系活动主要内容介绍	1. 2024 年工信部明确要求车规芯片国产化率 2025 年达 30%，公司车载 DDIC/TDDI 产品已量产交付，目前车规认证覆盖率及终端车企订单占比分别是多少？ 答:尊敬的投资者，您好！公司车载DDIC/TDDI 均已通过车规认证（AEC-Q100），所有订单均为前装车企订单。感谢您的关注。 2. 研发投入 9944 万元，其中用于 MEMS 微振镜项目的占比多少？ 答：尊敬的投资者，您好！2024年MEMS微振镜项目约占研发投入20%左右。感谢您的关注。

	3. 国家发改委 2024 年将 MEMS 产业纳入 “十四五” 新基建重点，公司 ϕ4mm MEMS 微振镜已通过类车规验证，预计何时能进入特斯拉、比亚迪等头部车企供应链？ 答:尊敬的投资者，您好！公司研发的MEMS微振镜产品，自动化装配设备调试已经完成，4mm规格的MEMS微振镜已进入批量生产阶段并将在工业领域实现应用。在车载领域，公司MEMS微振镜目前正在向国内相关车企提供送样，并配合特定项目的研发立项工作，同时也在同国际知名的tier one厂商就LBS路线的车载显示开发项目进行洽谈，感谢您的关注。 4. 在过去一年中有没有探索新的业务领域 答:尊敬的投资者，您好！在过去的一年中，公司致力于芯片、半导体研发制造等新业务领域的不断探索，并取得一系列的突破，其中车载DDIC、TDDI产品均已实现海内外前装车企订单的量产交付;MEMS振镜产品通过了在工业机器人领域的客户认证，目前配套产线已经完成调试，开始进入量产阶段，感谢您的关注！ 5. 目前现金流情况怎么样 答：尊敬的投资者，您好！目前公司现金流情况良好，满足公司日常经营活动。感谢您的关注。 6. 2024 年的研发成果有哪些？ 答:尊敬的投资者，您好！研发项目详细情况详见公司2024年度报告第22页“研发投入”章节。感谢您的关注。 7. 鉴于当前国家政策导向，各位领导认为未来所在行业的发展趋势将如何演变？ 答:尊敬的投资者您好，在芯片设计制造业务方面，全球芯片市场预计增长，中国集成电路产业生态进一步完善，国产替代率逐年攀升，但面临国际环境不确定性等挑战，半导体市场长期前景强劲，国产替代化将持续加码。电子元器件分销行业，2024年市场整体弱复苏，消费电子及新能源汽车等细分市场突出。2025年政策推动下汽车市场将稳中向好，AI手机渗透率持续提升，预计行业将迎来更广阔的发展空间和机遇。感谢您对公司的关注。 8. 请介绍一下未来3-5年的发展战略 答:尊敬的投资者，您好！公司在维持现有分销业务板块规模稳定的基础上，将持续加大在芯片设计制造方面的投入，期望在未来3到5年内，芯片研发制造业务在公司整体业务中的占比能显著提升，成为支撑公司持续发展的核心力量，助力公司在半导体领域实现更大
--	--

	突破。感谢您的关注。 9. 日本子公司去年的业绩情况怎么样 答:尊敬的投资者,您好!公司日本子公司英唐微技术有限公司2024年度单体实现营业收入4.4亿元,较同期增长19%左右。感谢您的关注。 10. 公司首款 DDIC 产品和 TDDI 产品分别于 2024 年 8 月和 12 月实现批量交付,后续改进型版本也已在研发中,目前 DDIC和 TDDI已取得哪些项目定点? 答:尊敬的投资者,您好!公司车载显示芯片已取得境内外多个仪表屏、中控屏项目定点。感谢您的关注。 11. 面对当前复杂的国际贸易环境,各位领导能分享一下准备了哪些应对措施来降低关税政策对公司的影响吗 答:尊敬的投资者,您好!根据2025年5月12日中美日内瓦经贸会谈联合声明,关税政策已有缓和形势,双方同步调整了关税税率。公司代理品牌涵盖日韩系、欧美系及本土系,其中欧美系品牌流片大多在台积电进行,关税对进货端影响甚微。同时,公司积极布局国产品牌代理,在国产替代进程中发挥重要作用,有力推动了国产品牌业务增长。在下游客户方面,部分客户产品最终销往美国,近期关税政策已有缓和迹象,预计该影响处于可控范围。公司积极通过业务布局调整以及国产替代策略,来应对关税政策的相关变化。感谢您的关注。 12. 公司是否有产业链整合计划? 答:尊敬的投资者,您好!探索并购机遇,加速半导体业务推进,已纳入公司今年的重点工作规划。过去近五年,公司致力于半导体业务转型升级,研发力量与产能多集中于境外。随着国内半导体市场需求的快速增长,为更高效地响应市场变化、把握发展机遇,公司计划在国内加强整体的产业布局。一方面,公司计划通过并购方式在国内组建自有研发团队,充分整合国内优秀人才资源,提升研发创新能力,使产品研发更贴合国内市场需求,缩短产品上市周期。另一方面,公司希望逐步在国内布局自有产能,实现研发、生产、销售的全产业链本地化。如此一来,既能降低运营成本,又能提高供应链的灵活性与稳定性,增强公司在国内市场的核心竞争力,为公司半导体业务的持续发展注入强劲动力。感谢您的关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

附件清单（如有）	
日期	2025年05月13日